【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年7月24日(2014.7.24)

【公表番号】特表2013-534734(P2013-534734A)
【公表日】平成25年9月5日(2013.9.5)
【年通号数】公開・登録公報2013-048
【出願番号】特願2013-519695(P2013-519695)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/304　(2006.01)
Ｂ２４Ｂ　37/00　(2012.01)
Ｂ２４Ｂ　53/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２２Ｍ
Ｂ２４Ｂ　37/00　Ａ
Ｂ２４Ｂ　53/00　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月9日(2014.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
研磨面及び該研磨面と反対側の裏面を有する金属基材を備え、前記研磨面に前記金属基材に付着した研磨粒子を含む研磨部材と、
受容面及び該受容面に隣接する周囲縁部を有し、前記受容面が前記研磨部材の裏面に取り付けられ、隣接する支持キャリアと、
前記周囲縁部に取り付けられた陽極と、
電解質溶液と接触した場合に、前記陽極から前記金属基材まで陰極防食電流を供給するよう構成される陰極防食回路と、を含む、化学機械平坦化用の陰極防食したパッドコンディショナー。
【請求項２】
半導体ウェハの化学機械平坦化中に請求項１に記載の陰極防食したパッドコンディショナーを使用する工程を含む、パッドのコンディショニング方法。